

中国国际金融股份有限公司
关于合肥晶合集成电路股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对晶合集成部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目基本情况

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，结合公司于2025

年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，和调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：亿元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	
		调整前	调整后
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	49.00	49.00
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	6.00	6.00
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	3.50	0.00
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	15.00	15.00
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	24.50	28.00
2	收购制造基地厂房及厂务设施	31.00	31.00
3	补充流动资金及偿还贷款	15.00	15.00
合 计		95.00	95.00

注：募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”调整后的拟使用募集资金金额未包括转出的募集资金专户扣除银行手续费后的利息收入及理财收益。

截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”，该项目已达到预定可使用状态并投入使用，满足结项条件。截至 2025 年 6 月 15 日，该募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额（A）	累计已投入募集资金金额（B）	利息收入及理财收益扣除手续费后净额（C）	节余募集资金金额（D=A-B+C）
40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	150,000.00	117,624.35	2,947.98	35,323.63

注：1. “节余募集资金金额”包含本项目尚未支付的合同尾款、设备款等款项，该部分款项

后续公司将通过自有资金支付；

2. “节余募集资金金额”未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；

3.上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

四、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本。

2、在“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”实施过程中，公司依托技术发展和项目实施积累的经验，深度融合生成式大语言模型（LLM）与判别式 AI 技术，构建自适应智能体（Agent）网络，实现了大模型驱动智能制造的创新。这一创新显著提升项目开发效率，降低人力和物力成本。此外，公司积极导入国产化软硬件，也在较大程度上降低了募投项目中设备及软硬件的采购费用。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

4、该募投项目已达到预定可使用状态，尚有部分合同尾款、设备款等款项待支付。因上述款项的支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续将通过自有资金支付。

五、节余募集资金的使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在该募投项目结项后，公司拟将募投项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”的节余资金 35,323.63 万元（截至 2025 年 6 月 15 日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司在中国银行股份有限公司合肥庐阳支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

七、公司履行的审议程序

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项无需提交公司股东会审议。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响。监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

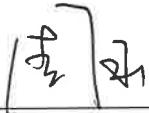
九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过并发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

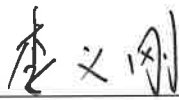
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周 玉



李义刚

